

证券代码：002669

证券简称：康达新材

## 康达新材料（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2025-009

|               |   |
|---------------|---|
| 投资者关系活动类别     | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 其他 _____   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 国金证券：王明辉、孙泽辉、杨啸、曹佳惠；国信证券：闵晓平；<br>国新证券：徐宪鹏；中金基金：邢瑶；汇添富基金：李宁；<br>华宝信托：顾宝成；上海国际信托：陈畅；正圆私募基金：徐彪；<br>卫宁私募基金：王兴佳；递归私募基金：于良涛；<br>犁得尔私募基金：马骄叶；途灵资产管理：赵梓峰；<br>伯兄资产管理：蔡天夫。  |
| 时间            | 2025年8月15日 16:00—17:00  |
| 地点            | 电话会议  |
| 上市公司接待人员姓名    | 副总经理、董事会秘书：沈一涛；中科华微总经理：赵峰；<br>投资者关系专员：安琪  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>董事会秘书沈一涛就公司半年报业绩预告情况及未来发展规划进行介绍，并对收购标的公司成都中科华微科技有限公司进行了简要介绍。</p> <p><b>Q1:请介绍一下公司2025年上半年业绩预告的具体情况？</b></p> <p><b>A:</b>业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，本期业绩实现扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计为盈利5,000.00万元-5,500.00万元，上年同期则为亏损5,651.10万元，同比增长188.48%-197.33%。</p> <p>2025年上半年，胶粘剂与特种树脂新材料板块产品销售总量稳步增长，带动净利润同步提升。其中，受益于风电行业景气度的提升，风电叶片系列产品需求较为旺盛，成为拉动板块业务增长的主要动力。其次，公司通过持续优化资源配置、提升资产运营效率、降低管理成本等举</p> |

措，进一步增强了盈利能力。

具体财务数据及分析请以 2025 年半年度报告披露数据及信息为准。

**Q2: 请介绍一下公司在风电叶片制造领域，竞争优势与业绩如何？**

**A:** 在风电叶片制造领域，作为公司核心业务的风电叶片结构胶始终保持国内市场份额第一的地位。依托胶粘剂板块的核心竞争力，公司已构建起覆盖风电叶片环氧结构胶、风电叶片环氧灌注树脂等核心产品的完整供应体系，成为行业头部企业的重要合作伙伴。

2024 年风电叶片环氧结构胶全年销量突破 4 万吨，风电叶片环氧灌注树脂销量达 4.5 万吨，且连续三年保持稳健增长态势。进入 2025 年，市场优势持续扩大，一季度风电叶片环氧结构胶销售量继续领跑行业。在“十四五”规划收官之年，面对风电行业的高速发展机遇，公司将进一步强化核心产品优势，充分发挥规模效应，持续提升市场竞争力，使风电叶片系列产品业务实现高质量增长。

**Q3: 请介绍一下成都中科华微的主要业务情况？**

**A:** 成都中科华微电子有限公司（以下简称“中科华微”）是一家专业从事高可靠集成电路产品研发和服务的高新技术企业，致力于为特种装备领域客户提供优质产品和服务。中科华微立足于核心技术，针对当前和未来市场需求，已形成微控制器芯片（MCU）、通用集成电路、高功率密度电源、系统级封装电路（SiP）四大产品管线，包括微控制器芯片 MCU（32 位微型控制器电路、16 位微控制器电路等）、系统级 SIP 芯片（射频综合控制 SIP 芯片、数据处理模块、异构处理器 SIP 芯片等）、各类模拟集成电路（存储器、电源管理、接口电路、信号链电路等）以及高功率密度电源等系列产品，尤其在特种装备 MCU 国产替代细分领域具有技术优势和市场影响力。中科华微被认定为第六批国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，获评四川省瞪羚企业、成都市企业技术中心，相关领域资质齐全。

中科华微以微控制器（MCU）、高功率密度电源和系统级封装电路（SiP）为核心，并拓展外围电路，形成完整的国产化解决方案，为客户提供增值与服务。中科华微在现有产品优势和市场规模的基础上，未来将进一步扩大完善产品谱系，围绕国家和客户需要，塑造数字电路和模拟电路双轮驱动的业务格局，服务特种装备领域快速发展的技术需求。

**Q4: 请介绍一下收购成都中科华微对公司的主要影响？**

**A:** 公司在“新材料+电子科技”的战略驱动下有序布局，拟通过本次收购实现在半导体集成电路领域的拓展，纳入特种集成电路领域的优质资产，双方在发展战略、市场渠道、产品与技术上均可获得协同效应。同时，在本次收购交易完成后，中科华微将纳入公司合并报表范围内，

|                 |   |
|-----------------|---|
|                 | <p>预期将给公司带来新的收入及利润增长点，提升公司盈利能力和持续经营能力，符合公司和全体股东的利益。</p> <p>作为国有控股企业，公司将以现有半导体材料产业（包括 CMP 抛光液、溅射靶材、陶瓷材料、电子化学品等）为基础，通过多元化投资模式，加速向半导体集成电路产业战略转型与升级。公司以突破关键领域“卡脖子”问题、填补国内空白为己任，立足“硬科技”，依托前期布局，着力构建涵盖集成电路设计、制造及封装测试的产业链条。公司战略布局高度契合国家产业政策导向，符合公司长远发展和战略规划。</p> <p><b>Q5：请介绍一下公司在电子级特种树脂领域有布局落地？</b></p> <p><b>A：</b>公司新设立的控股子公司康成达创（上海）新材料有限公司，主要规划产品为电子级双（多）马来酰亚胺树脂，可应用于高速覆铜板、BT 载板等领域。目前正开展技术测试、中试生产等相关前期工作。</p> |
| <b>附件清单(如有)</b> | 无   |
| <b>日期</b>       | 2025 年 8 月 17 日   |